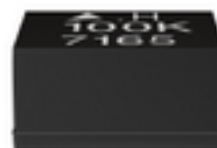


SMD

大小1210 (EIA) 或3225 (IEC) 的
额定电感0.1 ... 680 μ H
额定电流61 ... 2050毫安



施工

- 铁氧体磁芯
- 激光焊接绕组
- 阻燃成型

特点

- 温度范围高达+150°C
- 非常高的电流处理能力
- 符合AEC -Q200标准
- 适用于无铅回流焊
如引用在JEDEC J -STD 020D
- 符合RoHS标准

应用

- 电源电压滤波，耦合，去耦
- 的DC / DC转换器，开关式电源
- 汽车电子（如单线总线系统）
- 电信
- 消费者和数据处理设备
- 工业电子产品

码头

- 基材CuSn6
- 层组合物，铜，银，锡（无铅） 1)
- 电镀

记号

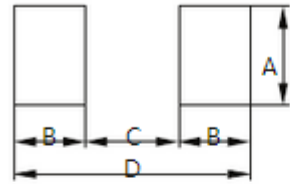
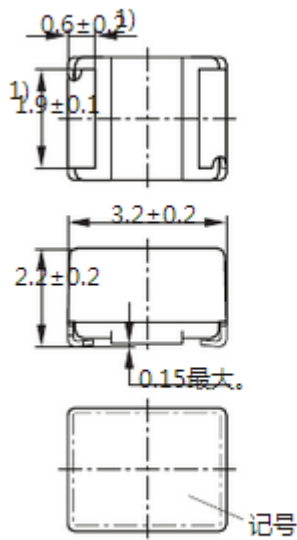
- 基于组件的标记：
制造商和字母“H”，L值（以 μ H）
L值（编码），生产日期的耐受性（YWW D）
- 盘上最小的数据：
制造商，订货代码，L价值，数量，包装日期

分块方式及包装单位

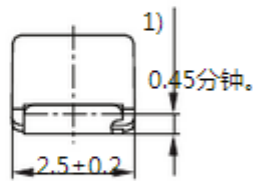
- 8毫米吸塑带，缠绕在180毫米或330毫米 REEL
- 包装单位：
180毫米的卷筒：2000个/卷。
330毫米的卷筒：7500个/卷。

SMD

尺寸图和布局的建议



IND0053-6



A	B	C	D
2.7	1.15	2.1	4.4

1) 焊接区

IND0496-P-E 尺寸 (mm)

技术参数和测量条件

额定电感L	R	测量阻抗分析仪Agilent 4294A 在频率f L, 0.1 V, + 20 °C,
Q因子Q民		测量阻抗分析仪Agilent 4294A 在频率f Q +20 °C
额定温度T	R	+105 ^{θX}
额定电流I	R	最大允许的DC与电感下降 ΔL/L ₀ δ 为10%和温度的增加 of δ 45钾养分额定温度
自谐振频率f	水库, 分	测量阻抗分析仪Agilent 4294A, 20 °C,
直流电阻R	最大	测量20 θX
焊(无铅)		Sn95.5Ag3.8Cu0.7 : + R ⁽⁵⁾ 245 (5 P ^{0.3}) s 润湿焊接区 τ 90% (根据IEC 60068-2-58)
焊锡耐热性		+260 ^{θX} 40秒(以引用的JEDEC J -STD 020D)
气候类别		55/150/56 (符合IEC 60068-1)
储存条件:		安装: -55 °C ~ +150 °C 包装: -25 °C ... + 40 °C, δ 75%RH下
重量		约。 50毫克